

ホットランナシステム サモコンゲート

THERMO-CON GATE HOT RUNNER SYSTEM

概要

サモコンゲートは、射出時にはゲート先端を発熱させ樹脂を溶融し、製品取出し時は、ゲート先端の温度を下げ樹脂を固化させてシールする「熱的ゲートシール方式」を採用するホットランナシステムです。

特長

- ・独自の発熱システム
サモコンゲートは従来のヒーター等を全く使用しない独自の発熱システムを採用しています。これにより高レスポンスと精密な温度コントロールを実現しています。
- ・完全中空形状
ヒーター、バルブピン等の流動抵抗物が樹脂流路内に一切存在しないため、圧力損失が極端に小さく、抜群の流動性を発揮します。

用途

- ・ゲート点数の削減
ウエルド不良の削減
ホットランナの小型化
金型費の削減
- ・スプルー、ランナレス
後仕上工程削減
成形材料の節約
- ・引当成形機の小型化
約30%の小型化が可能
- ・成形サイクルタイムの短縮
約50%の保圧時間短縮が可能
- ・高品質成形
金型転写製の向上



Overview

Thermo-con Gate hot runner system is based on the thermal gate-seal method to heat the gate to melt resin in injection process and cool the gate to solidify resin in mold-opening and product ejection process.

Feature

Unique heating system
The heating system of Thermo-con Gate is unique; that does not use normal heaters. Thus, high response and precise temperature control are realized.
Ultimate hollow structure
Because there are no obstacles such as heaters or valve-pins inside the resin path, the pressure-loss becomes MIN. and excellent flow-performance is made up. Applications

Application

Reduction of gate points
Elimination of weld line
Down-sizing of hot-runner block
Reduction of the die cost
Sprue-less and runner-less
No trimming process
Saving the material
Down-sizing of applied injection machine
Machine size can be smaller by approx.30%.
Reduction of cycle time
Holding-pressure time can be shorter by approx.50%.
High quality molding
Improvement of transcriptional ability

写真左から (from left)

S1210-T (小物成形品用)
(For small products)

BS164I-T (中、小物成形品用)
(For small or middle products)

BS187Y-A (大物成形品用)
(For big products)

エスイピ株式会社

SEP CO., LTD.

〒472-0043 愛知県知立市東栄3-48
TEL.0566-82-6050 FAX.0566-82-5211
3-48 TOUEI, CHIRYU-SHI, AICHI 472-0043
TEL.+81-566-82-6050 FAX.+81-566-82-5211
<http://www.sep-hot.co.jp> E-mail:eigyo@sep-hot.co.jp